

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“晶丰明源”）于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。

2025 年，以培育新质生产力为核心目标，公司结合自身发展战略和经营情况，制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。具体内容如下：

一、推进主营业务发展，积极提升经营质量

2024 年，公司在稳固 LED 照明驱动芯片这一基石业务的同时，积极拓展 AC/DC 电源芯片及电机控制驱动芯片业务，并推动高性能计算电源芯片进入规模量产阶段。通过优化产品结构、加强供应链管理、提升工艺技术等方式，公司整体营业收入持续增长，毛利率显著提升，经营数据有显著改善。

2024 年度，公司实现销售收入 15.04 亿元，同比增长 15.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.33 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.09 亿元。剔除股份支付费用影响后，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 0.09 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.04 亿元。

在 LED 照明驱动芯片产品领域，公司通过扩大智能 LED 照明产品的市场布局，在可控硅调光业务及高性能灯具电源业务上保持领先地位，同时实现北美 0-10V 调光大功率照明产品、DALI 调光业务的显著增长，通过供应链整合与工艺技术迭代，产品单位成本下降 27.22%，产品结构优化和成本大幅下降，毛利率

显著提升。

公司 AC/DC 电源芯片业务在 2024 年实现稳步增长，其中大家电领域业务已初具规模，在空调、冰箱及抽油烟机等多个应用场景实现规模收入。小家电业务保持高速增长，与九阳、小熊、徕芬、Sharkninja、美的、苏泊尔等客户达成稳定合作。快充业务方面，公司推出基于 ACOT 控制及磁耦通讯技术的零待机功耗方案，满足七级能效及零待机功耗要求，成功进入国际知名手机品牌供应链。

电机控制驱动芯片产品领域，公司通过技术创新持续提升产品集成度和性能，推动业务高速发展。报告期内，公司对高速风筒、电动工具和清洁电器相关产品进行迭代并进入市场；汽车电子业务破局，空调出风口产品实现销量超百万颗；大家电业务方面，在热泵干衣机领域成为领先的国内电机控制芯片供应商，在美的等品牌客户实现多品类量产；吊扇、电动出行及清洁电器业务市场占有率位居前列。

经过持续研发投入，2024 年公司高性能计算产品线实现多相控制器、DrMOS、POL 及 Efuse 全系列产品量产，实现部分国际、国内客户业务破局，进入规模销售阶段，当年实现销售收入 0.43 亿元，同比上升 1,402.25%。截至报告期末，公司产品已获得国际、国内多家 CPU/GPU 芯片厂商认证，其中 16 相双轨数字 PWM 控制器 BPD93136、4 相 PWMVID 数字 PWM 控制器 BPD93204 以及集成智能集成功率器件 BPD80350E 产品组合方案符合 NVIDIA 最新的 OpenVReg 电源规范 OVR16 和 OVR4-22，成为首家进入 NVIDIA 推荐供应商名单的国内电源芯片企业。

2025 年，公司将继续积极推进各产品线持续创新与市场拓展，为公司未来的跨越式发展奠定坚实基础。

针对同质化较高的通用 LED 照明业务，公司将依托工艺和封装优势，确保具有竞争力的毛利率水平。在智能 LED 照明领域，通过提升产品集成度和性能，持续迭代优势产品，进一步扩大市场份额；同时，通过与客户共同开发定制化产品，构建技术壁垒，推动业务持续扩展。

在内置 AC/DC 业务方面，2025 年将在现有客户基础上，进一步拓展白电产品品类的覆盖范围，稳步推进业务增长。小家电业务通过技术创新、方案优化等方式进一步扩大市场份额。在充电器和适配器领域，依托技术方案的优势，公司

将实现一线品牌客户的突破，并提升现有客户的份额。

在电机控制驱动芯片领域，公司将加大在汽车电子、大家电及服务器热管理市场的研发投入。在电动出行、清洁电器等成熟市场，持续扩大市场份额；在汽车电子、大家电等新兴市场，推动头部客户业务突破。公司将在算法平台开发方面重点投入，持续迭代生态体系，保持技术领先优势。

公司将持续夯实高性能计算产品现有业务，立足国内市场并持续拓展海外市场，实现国际头部客户的规模量产。同时，抓住国产替代的市场机遇，持续提升国内主芯片厂业务份额，在 AIC、PC、服务器等领域扩大销售收入。

二、持续研发投入，重视产品创新，提升工艺能力

作为国内领先的电源管理芯片及电机控制驱动芯片设计企业之一，公司始终重视研发投入与技术积累，拥有丰富的集成电路设计经验及多项专利、专有技术，多项核心技术处于国际或国内先进水平。2024 年，公司累计投入研发费用近 4.00 亿元，占营业收入比例为 26.58%。公司研发费用的投入与研发成果的产出呈正向循环的趋势。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得境内发明专利授权 200 个，获得境外发明专利授权 47 个，实用新型专利 239 个，外观设计专利 2 个，软件著作权 34 个，集成电路布图设计专有权 325 个。

自有工艺平台确保了公司供应链选择的灵活性、稳定性，并在保证产品高性能的同时，不断提升产品成本的竞争力。在不断进行新产品研发的同时，公司投入资源进行自有工艺平台 BCD-700V 高压工艺的技术迭代工作，第五代高压工艺实现全面量产，第六代高压工艺平台的研发已经完成，成本优化 20%，进一步巩固技术领先优势。

封装技术方面，公司独占封装 EHSOP12 已进入量产阶段，EMSOP 封装技术也在持续研发中，预计将进一步带动成本下降。

基于新业务需求，公司还投入资源研发 0.18 μm 低压 BCD 工艺，目前已实现量产，性能接近国际主流产品，助力公司高性能计算电源芯片量产。

公司计划在 2025 年将 BCD-700V 第六代工艺平台投入量产，预计带来 20% 成本优化。同时，公司与上游供应商合作开发封装平台。工艺平台及封装技术的全面导入，将进一步降低生产成本，增强市场竞争力。在高性能计算电源芯片相关工艺方面，公司将完成自有 0.18 μm BCD 第二代平台的设计并推进 65nm

LDMOS 工艺平台的量产进程。

三、推进重大资产重组，力求双方高效整合

为拓展产品布局、提升市场竞争力，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票于 2024 年 10 月 22 日（星期二）开市起停牌，并于 2024 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称“易冲科技”或“标的公司”）100%股权的事项；自 11 月 5 日开市起公司股票复牌，同日在上海证券交易所披露《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。

截至目前，公司已根据相关《购买资产协议》的约定向标的公司指定账户支付了人民币 1,500 万元的诚意金，并已分别与华泰联合证券有限责任公司、上海市方达律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、金证（上海）资产评估有限公司等中介机构签订服务协议，聘任上述机构为本次重组交易提供相应的独立财务顾问、法律、财务审计及资产评估服务。

2025 年，公司将持续严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极有序地推进本次重组交易筹划事项的各项工 作，履行后续必要的审议程序与信息披露义务。

交易完成后，晶丰明源与易冲科技将在产品端高度互补，在客户端共享资源、协同开拓市场，提升公司“硬科技”属性和国际化水平，夯实消费领域市场地位和技术能力，进一步加强车规级产品的布局和突破，助力公司向新质生产力方向继续深化发展。

四、建立有效的激励约束机制，优化组织架构，推动高质量发展

为充分调动员工积极性和创造性，公司通过股权激励与薪酬相结合的方式吸引人才，研发团队的有序扩张保证了公司在电源管理芯片领域的进一步发展。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员共 422 人，占公司员工总数的 68.17%。2025 年，公司将保持高比例研发人员，在市场条件及公司内部条件合适时，利用股权激励等方式进一步加强核心员工绑定，通过不断完善薪酬激励体系及绩效管理体系，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。

2025年，根据业务发展战略，公司将进一步优化组织架构，使组织形式更加贴合公司业务及各事业部发展需要，不断提升公司管理水平及运营效率，确保公司发展战略和经营目标的实现。

五、完善公司治理结构，强化董监高培训

1、公司内部治理制度完善与优化

2025年，公司将根据新《公司法》的修订情况、密切关注《上市公司章程指引》的修订及发布，调整三会架构、及时更新修订公司内部管理制度，确保公司规范运作，保障投资者权益。

2、贯彻落实关键人员培训

2024年，公司为时任董监高安排参加了中国上市公司协会、上海上市公司协会、上海证券交易所等组织机构举办的多场专题培训。

2025年，公司将组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关方积极参加至少2次由上海证券交易所、中国证券监督管理委员会上海监管局、上海上市公司协会等组织机构举办的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司将持续关注资本市场新规及监管趋势等信息，及时将信息传递给公司董事会及管理层，保持与监管政策的紧密衔接，积极配合资本市场监管机制。

六、重视股东回报，提振市场信心

公司高度重视投资者回报，在满足分红条件的前提下，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，在关注公司自身投资价值的基础上，进一步增强投资者回报水平，结合公司目前整体经营情况及公司发展阶段，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配，不转增股本，不送红股。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）。截至目前，公司总股本87,826,470股，扣减回购专用证券账户中的股份913,580股后，实际参

与分配的股本数为 86,912,890 股，以此计算合计拟派发现金分红 43,456,445 元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024 年，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，经公司董事会批准，同意以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励与维护公司价值及股东权益。公司于 2024 年 2 月开始实施股份回购，截至 2024 年 12 月 31 日，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购公司股份 913,580 股，回购金额共计 59,983,530.70 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上，公司 2024 年度现金分红总额为人民币 103,439,975.70 元。

综合本年度现金分红方案，剔除 2022 年度、2023 年度因市场供需影响等因素导致亏损未进行现金分红，公司上市以来已累计现金分红 4.48 亿元。

2025 年，公司将在年度股东大会审议通过后，推进 2024 年度利润分配方案的实施。未来，公司将结合经营发展需要以及业务战略目标，研究中期分红、多次分红的可行性，合理提高分红率和股息率，维护广大股东的合法权益，保证公司长期稳健的发展，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，坚持“投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报，实现公司与投资者的互利共赢。

七、提高信息披露质量，丰富投资者沟通渠道，提升投资者关系管理实效

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及有关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，提高信息披露的质量和透明度，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。

2025 年，公司将通过以下举措，进一步提升投资者关系管理工作质量：

1、公司将努力增加与投资者接触的频次，畅通公司与投资者的沟通渠道。全年举办不少于 3 次的业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答。同时，全年举行不少于 4 次的投资者调研活动，邀

请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。

2、以投资者需求为导向，持续提升信息披露内容的可读性和有效性，切实维护投资者获取信息的平等性。

八、持续评估完善行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受到宏观政策调整、行业环境变化等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2025年3月10日